



平成30年3月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕（連結）

平成30年1月30日

上場会社名 株式会社トーマンデバイス 上場取引所 東
 コード番号 2737 URL <http://www.tomendevices.co.jp/>
 代表者 (役職名) 代表取締役社長 (氏名) 妻木 一郎
 問合せ先責任者 (役職名) 経理部長 (氏名) 原 英記 TEL 03-3536-9150
 四半期報告書提出予定日 平成30年2月13日 配当支払開始予定日 ー
 四半期決算補足説明資料作成の有無：無
 四半期決算説明会開催の有無：無

(百万円未満切捨て)

1. 平成30年3月期第3四半期の連結業績（平成29年4月1日～平成29年12月31日）

(1) 連結経営成績（累計）

(%表示は、対前年同四半期増減率)

	売上高		営業利益		経常利益		親会社株主に帰属する 四半期純利益	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%
30年3月期第3四半期	149,416	31.0	2,002	94.8	1,672	12.9	1,215	9.6
29年3月期第3四半期	114,048	△24.4	1,027	△41.2	1,481	0.0	1,108	11.4

(注) 包括利益 30年3月期第3四半期 1,476百万円 (17.6%) 29年3月期第3四半期 1,255百万円 (16.7%)

	1株当たり 四半期純利益	潜在株式調整後 1株当たり 四半期純利益
	円 銭	円 銭
30年3月期第3四半期	178.75	155.63
29年3月期第3四半期	163.03	135.24

(2) 連結財政状態

	総資産	純資産	自己資本比率	1株当たり純資産
	百万円	百万円	%	円 銭
30年3月期第3四半期	79,491	27,516	34.5	4,027.10
29年3月期	70,519	26,448	37.4	3,873.53

(参考) 自己資本 30年3月期第3四半期 27,389百万円 29年3月期 26,345百万円

2. 配当の状況

	年間配当金				
	第1四半期末	第2四半期末	第3四半期末	期末	合計
	円 銭	円 銭	円 銭	円 銭	円 銭
29年3月期	—	0.00	—	60.00	60.00
30年3月期	—	0.00	—	—	—
30年3月期(予想)	—	—	—	70.00	70.00

(注) 直近に公表されている配当予想からの修正の有無：無

3. 平成30年3月期の連結業績予想（平成29年4月1日～平成30年3月31日）

(%表示は、対前期増減率)

	売上高		営業利益		経常利益		親会社株主に帰属 する当期純利益		1株当たり 当期純利益
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%	円 銭
通期	190,000	21.3	2,300	83.6	2,000	18.3	1,500	21.9	220.54

(注) 直近に公表されている業績予想からの修正の有無：無

※ 注記事項

(1) 当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動）：無

(2) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用：有

(注) 詳細は、添付資料6ページ「2. 四半期連結財務諸表及び主な注記(3) 四半期連結財務諸表に関する注記事項(四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用)」をご参照下さい。

(3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

- ① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更 : 無
- ② ①以外の会計方針の変更 : 無
- ③ 会計上の見積りの変更 : 無
- ④ 修正再表示 : 無

(4) 発行済株式数（普通株式）

① 期末発行済株式数（自己株式を含む）	30年3月期3Q	6,802,000株	29年3月期	6,802,000株
② 期末自己株式数	30年3月期3Q	611株	29年3月期	538株
③ 期中平均株式数（四半期累計）	30年3月期3Q	6,801,455株	29年3月期3Q	6,801,505株

※ 四半期決算短信は四半期レビューの対象外です

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

(将来に関する記述等についてのご注意)

業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づいており、その達成を当社として約束する趣旨のものではありません。また、実際の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。

○添付資料の目次

1. 当四半期決算に関する定性的情報	2
(1) 経営成績に関する説明	2
(2) 財政状態に関する説明	2
(3) 連結業績予想などの将来予測情報に関する説明	2
2. 四半期連結財務諸表及び主な注記	3
(1) 四半期連結貸借対照表	3
(2) 四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書	4
四半期連結損益計算書	
第3四半期連結累計期間	4
四半期連結包括利益計算書	
第3四半期連結累計期間	5
(3) 四半期連結財務諸表に関する注記事項	6
(継続企業の前提に関する注記)	6
(株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記)	6
(四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用)	6
3. 補足情報	6

1. 当四半期決算に関する定性的情報

(1) 経営成績に関する説明

当第3四半期連結累計期間における我が国経済は、雇用所得改善が続くなか、個人消費は緩やかな回復基調を維持しており、また企業収益は改善を続けており、海外経済も、米国を中心に雇用情勢・所得環境の改善が続いたことに加え、企業収益の回復に連動して設備投資にも持ち直しの動きがみられるようになり、全体としては緩やかな回復基調が続いております。その一方で、欧米の政治的リスクやアジアにおける地政学的リスクの高まりによる景気下振れへの懸念材料は依然として残っております。

エレクトロニクス業界におきましては、スマートフォンメーカーが、部品コストの上昇に対応して値上げを余儀なくされていることもあり、ミッドレンジからハイエンドまでのスマートフォン需要が減速している動きが見受けられるものの、エンタープライズ、データセンター、車載および産業機器向けの半導体および電子部品需要は好調であり、一部では、供給不足が長期化しております。またPCにおいては、出荷台数が若干上向き傾向にあり、デジタルカメラも長年低迷が続いておりましたが、SNS等の画像共有サービスに高画質画像を投稿したいというニーズの高まりもあり、復調の兆しが見えてきております。

このような状況下、当社グループは、国内市場ではPC、サーバー・ストレージ向けにSSD（ソリッドステートドライブ）、スマートフォン向けに有機ELをそれぞれ拡販し、中国市場では、スマートフォン向けにCIS（CMOSイメージセンサ）及びMCP（マルチチップ・パッケージ）の販売を大きく伸ばしたことから、売上高は1,494億16百万円（前年同期比31.0%増）、営業利益は20億2百万円（同94.8%増）、経常利益は16億72百万円（同12.9%増）、親会社株主に帰属する四半期純利益は12億15百万円（同9.6%増）となりました。

当社は、米ドル建ての外貨取引については、為替予約により為替相場の変動リスクを回避しております。為替相場が急速に変動した場合、仕入と売上の計上時の為替レート差が生じ、円高の場合は、売上総利益、営業利益は減益に、円安の場合は増益になります。しかし、営業外損益にて見合いの為替差損益が発生することにより、経常利益においては、概ね、契約時点で見込んだ利益額が計上されます（当社は、「金融商品に関する会計基準」における原則的なヘッジ会計を適用しており、特例としての振当処理は行っておりません。）。

なお、急速な為替相場の変動による影響として、当第3四半期連結累計期間において為替差損1億83百万円（前年同期は為替差益4億86百万円）が営業外損益に計上されております。

(2) 財政状態に関する説明

当第3四半期連結会計期間末の総資産の残高は794億91百万円（前連結会計年度末比12.7%増）となりました。これは主に受取手形及び売掛金と商品の増加によるものです。

負債は519億74百万円（同17.9%増）となりました。これは主に買掛金の増加によるものです。

純資産は275億16百万円（同4.0%増）となりました。これは主に親会社株主に帰属する四半期純利益の計上と配当金の支払によるものです。

(3) 連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

連結業績予想につきましては、平成29年10月26日に発表いたしました通期の連結業績予想に変更はありません。

2. 四半期連結財務諸表及び主な注記

(1) 四半期連結貸借対照表

(単位：百万円)

	前連結会計年度 (平成29年3月31日)	当第3四半期連結会計期間 (平成29年12月31日)
資産の部		
流動資産		
現金及び預金	990	4,305
受取手形及び売掛金	32,583	42,475
商品	11,531	23,738
前渡金	7,108	3,598
繰延税金資産	210	224
預け金	16,869	3,176
その他	342	735
流動資産合計	69,637	78,254
固定資産		
有形固定資産	54	50
無形固定資産	42	92
投資その他の資産	784	1,093
固定資産合計	881	1,236
資産合計	70,519	79,491
負債の部		
流動負債		
買掛金	12,641	29,105
短期借入金	13,108	14,080
未払法人税等	38	183
賞与引当金	126	54
未払金	17,041	6,462
その他	759	1,671
流動負債合計	43,717	51,557
固定負債		
退職給付に係る負債	316	335
その他	37	82
固定負債合計	353	417
負債合計	44,070	51,974
純資産の部		
株主資本		
資本金	2,054	2,054
資本剰余金	1,984	1,984
利益剰余金	21,707	22,514
自己株式	△1	△1
株主資本合計	25,744	26,551
その他の包括利益累計額		
その他有価証券評価差額金	144	369
繰延ヘッジ損益	5	△17
為替換算調整勘定	451	485
その他の包括利益累計額合計	601	838
非支配株主持分	102	126
純資産合計	26,448	27,516
負債純資産合計	70,519	79,491

(2) 四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書

(四半期連結損益計算書)

(第3四半期連結累計期間)

(単位：百万円)

	前第3四半期連結累計期間 (自平成28年4月1日 至平成28年12月31日)	当第3四半期連結累計期間 (自平成29年4月1日 至平成29年12月31日)
売上高	114,048	149,416
売上原価	111,733	145,869
売上総利益	2,314	3,546
販売費及び一般管理費	1,286	1,543
営業利益	1,027	2,002
営業外収益		
受取利息	6	6
受取配当金	11	13
仕入割引	28	—
為替差益	486	—
持分法による投資利益	22	31
その他	24	5
営業外収益合計	579	56
営業外費用		
支払利息	88	166
債権売却損	10	15
支払手数料	13	7
為替差損	—	183
その他	12	13
営業外費用合計	125	386
経常利益	1,481	1,672
税金等調整前四半期純利益	1,481	1,672
法人税等	345	434
四半期純利益	1,136	1,238
非支配株主に帰属する四半期純利益	27	22
親会社株主に帰属する四半期純利益	1,108	1,215

(四半期連結包括利益計算書)
(第3四半期連結累計期間)

(単位：百万円)

	前第3四半期連結累計期間 (自 平成28年4月1日 至 平成28年12月31日)	当第3四半期連結累計期間 (自 平成29年4月1日 至 平成29年12月31日)
四半期純利益	1,136	1,238
その他の包括利益		
その他有価証券評価差額金	74	225
繰延ヘッジ損益	△64	△23
為替換算調整勘定	108	36
その他の包括利益合計	119	238
四半期包括利益	1,255	1,476
(内訳)		
親会社株主に係る四半期包括利益	1,223	1,452
非支配株主に係る四半期包括利益	32	24

(3) 四半期連結財務諸表に関する注記事項

(継続企業の前提に関する注記)

該当事項はありません。

(株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記)

該当事項はありません。

(四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用)

(税金費用の計算)

税金費用については、当第3四半期連結会計期間を含む連結会計年度の税金等調整前当期純利益に対する税効果会計適用後の実効税率を合理的に見積り、税金等調整前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算しております。

3. 補足情報

(品目別販売実績)

品目別	前第3四半期連結累計期間 (自 平成28年4月1日 至 平成28年12月31日)		当第3四半期連結累計期間 (自 平成29年4月1日 至 平成29年12月31日)		増減率 (%)	前連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)	
	金額 (百万円)	構成比 (%)	金額 (百万円)	構成比 (%)		金額 (百万円)	構成比 (%)
メモリー	59,491	52.2	77,226	51.7	29.8	82,917	52.9
システムLSI	22,172	19.4	34,140	22.8	54.0	28,282	18.1
半導体小計	81,663	71.6	111,366	74.5	36.4	111,199	71.0
液晶デバイス	19,817	17.4	28,029	18.8	41.4	28,012	17.9
その他	12,568	11.0	10,021	6.7	△20.3	17,466	11.1
合計	114,048	100.0	149,416	100.0	31.0	156,677	100.0

(メモリー半導体)

DRAM、NAND等の価格が高値を維持する中、国内市場では、PC向けSSD (ソリッドステートドライブ)、サーバー・ストレージ向けDRAMおよびスマートフォン向けMCP (マルチチップ・パッケージ) の販売がそれぞれ好調であり、中国市場においても、スマートフォン向けMCPの販売が大幅に伸長したため、この分野の売上高は772億26百万円 (前年同期比29.8%増) となりました。

(システムLSI)

中国でスマートフォン向けCIS (CMOSイメージセンサ) 等の販売が大幅に伸び、国内ではタブレット向けDDI (ディスプレイドライバーIC) の販売が堅調であったため、この分野の売上高は341億40百万円 (同54.0%増) となりました。

(液晶デバイス)

デジタルサイネージ向けの販売が伸び悩む一方、モニター向け需要が好調であったことに加え、国内・中国双方でテレビ向けの販売が伸びたため、この分野の売上高は280億29百万円 (同41.4%増) となりました。

(その他)

国内でスマートフォン向け有機ELパネルの販売が伸びたものの、テレビ用バックライト向けLEDの販売が減少したため、この分野の売上高は100億21百万円 (同20.3%減) となりました。